

产品概述:

该芯片是一颗基于BT/BLE5.3双模协议栈以及BLE Audio标准开发的高规格蓝牙音频SoC。内置高性能HiFi 5 DSP和NPU，并集成Hybrid ANC，支持以极低功耗实现复杂的多麦克风上行降噪算法和语音唤醒。同时提供丰富的接口，集成度高，适用于高带宽、深降噪的高级TWS降噪耳机和其他需要复杂的音频处理和语音AI能力的低功耗产品。

优势特性:

- 支持BT/BLE 5.3双模协议栈;
- 支持LE Audio新技术标准和 LC3 编解码器;
- 集成Hybrid (FF+FB) 混合式ANC主动降噪;
- 更大SRAM和FLASH空间，实现应用特性更广覆盖;
- 升级射频相关性能;
- 作为平台开放，支持更多产品形态;

应用领域:



TWS耳机

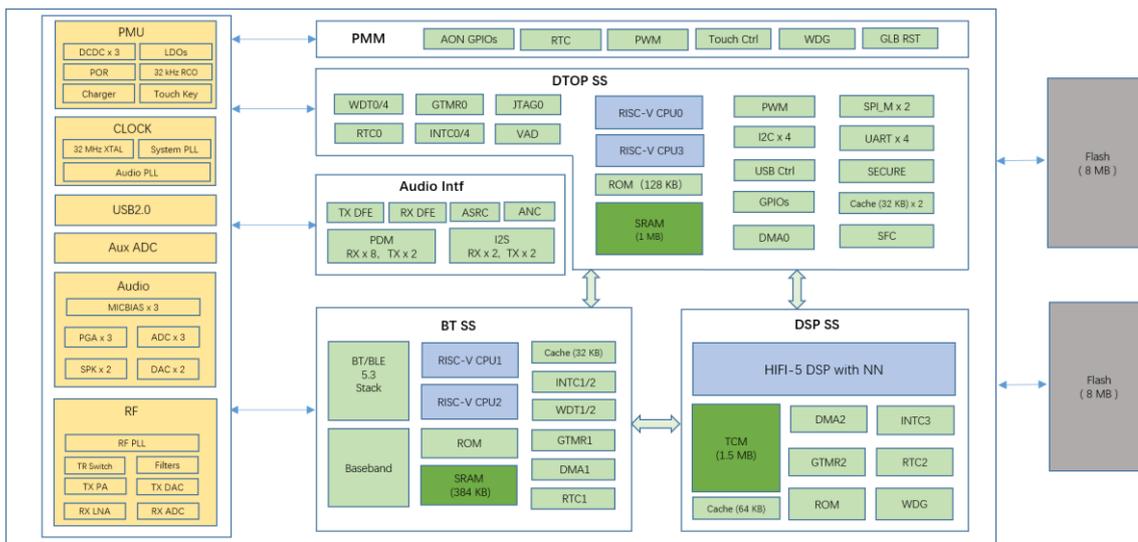


游戏耳机



蓝牙音箱

产品框图:



版权所有 © 重庆物奇微电子有限公司 2023。保留一切权利。未经版权所有人的书面许可，本文档的任何部分不得转载。

免责声明

由于在方法、设计和制造方面的不断进步，本文档的内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，重庆物奇微电子有限公司对使用本文档所产生的任何错误或损害不负任何责任。